



HJT电池电镀金属化设备

HJT Cell Plating Metallization Equipment

特点描述

- 脉冲式连续式药液接触沉积方式;
- 超近阴阳极距离, 高电流密度;
- 无工装夹具水平流片工艺方式;
- 阶梯式电流密度调控。

Features

- Pulse type&continuous type deposition mode;
- Ultra-close cathode and anode distance, High current density;
- Fixtureless, horizontal in-line process;
- Laddering current density regulation.

技术性能

传输轨道: 5道;
硅片尺寸: 210*210mm;
产能: ≥3600pcs/h;
设备Uptime: ≥95%;
设备产品良率>99.9%。

Performance

Transfer ways: 5;
Wafer size: 210*210mm;
Capacity: ≥3600pcs/h;
Uptime: ≥95%;
Product yield >99.9%.

技术参数 Parameter

项目 Item	数值 Value
设备尺寸 Layout dimension	35960mm* 2500mm*2500mm